

2025年4月15-17日

上海新国际博览中心

# 2025 ( 第三届 ) 国际汽车电子 技术创新论坛

2025 International Automotive Electronics  
Technology Innovation Forum



## 基本信息 General Information

<b>会议时间 : Date :</b>	2025年4月15日 Apr 15,2025
<b>会议地点 : Venue</b>	上海新国际博览中心, N3现场论坛区 On-site Forum Area in Hall N3, Shanghai New International Expo Center
<b>主办单位 : Organizer :</b>	上海市交通电子行业协会 Shanghai Transportation Electronics Association 上海浦东汽车电子创新与智能产业联盟 Shanghai Pudong Automotive Electronics Innovation and Intelligent Industry Alliance 慕尼黑展览(上海)有限公司 Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.
<b>会议语言 : Language :</b>	中文或英文, 现场不提供同声传译(建议英文演讲嘉宾使用双语PPT) Chinese or English, no simultaneous interpretation (Non-Chinese speakers are recommended to use bilingual slides)
<b>演讲资料提交 : Material Submission Deadline :</b>	- 中英文演讲题目、演讲文简介和照片、250字演讲摘要提交: 截止日期2025年1月15日 - 演讲PPT提交: 截止日期2024年2月28日 - Bilingual info of subject and speaker, presentation abstract of 250 words: 15 Jan, 2025 - Complete PPT submission: 28 Feb, 2025

## 主要议题 Topics

- 人工智能及自动驾驶
- 汽车智能芯片
- 逻辑控制芯片
- ADAS与自动驾驶环境感知技术(视觉摄像头、激光雷达、毫米波雷达)
- 多传感器集成及多源信息融合
- 高精度地图及定位
- 智能网联汽车人机交互技术
- 车联网技术
- 5G技术在车联网中的应用
- V2X技术
- 车联网平台发展
- 自动驾驶汽车仿真与测试
- Artificial Intelligence & Automated Driving
- Smart Chips for Vehicle & Automatic Driven
- Logic Control IC
- Environmental Sensing Technology for ADAS and Automatic Driving System (Camera, LiDAR, MMW Radar)
- Multi-sensor Integration & Multi-source Information Fusion
- High Precision Map and Positioning
- HMI Technology for Intelligent Connected Vehicle
- Internet of Vehicles Technology
- Application of 5G Technology in IoV
- V2X Technology
- Thoughts of Telematics Platform Development
- Testing Technology for Intelligent Connected Vehicle



# 2024 论坛议程回顾 2024 Review of Agenda

主持人：黄峰，上海市交通电子行业协会，秘书长

Moderator: Huang Feng, Secretary-General, Shanghai Transportation Electronics Association

E

时间Time	演讲题目Presentation	演讲嘉宾Speaker
9:30-9:45	签到入场 Registration	
9:45-10:15	智能汽车时代下的用户体验思与变 Thinking and Changing about User Experience in the Era of Intelligent Vehicles	杨永喆，长城汽车，产品数字化中心副总监 Jared Yang, Deputy Director of Product Digitalization Center, Great Wall Motor
10:15-10:45	国产车规中高端MCU芯片技术发展路径探讨 Discussion on the Technical Roadmaps of Domestic Automotive MCUs in the Middle-to-High-End Field	肖佐楠，苏州国芯科技股份有限公司，总经理 Joe Xiao, GM, C*Core Technology Co., Ltd.
10:45-11:15	助力中国汽车迈向高性能、高可靠的电动化与智能化 To enable Chinese automobile move towards high-performance, highly reliable electrification and intelligence	陈晟，ADI中国汽车电子市场总监 Edward Chen, Marketing Director, ADI China Automotive Business
11:15-11:45	智能驾驶“一站式”解决方案 The Solution of Intelligent Driving	彭嘉成，意法半导体，市场经理 Jerry PENG, Marketing Manager, STMicroelectronics
11:45-12:15	KungFu内核车规MCU助力汽车芯片国产化 The KungFu core automotive-grade MCU contributes to the localization of automotive chips	卢恒洋，上海芯旺微电子技术有限公司，产品总监 Ethan Lu, Product Director, Shanghai ChipON Microelectronics Technology Co., Ltd

主持人：杨永喆，长城汽车，产品数字化中心副总监

Moderator: Jared Yang, Deputy Director of Product Digitalization Center, Great Wall Motor

时间Time	演讲题目Presentation	演讲嘉宾Speaker
13:00-13:30	未来健康智能座舱 Intelligent In-cabin Wellness Experience	景纯灵，福特汽车，体验设计总监 Claire Ching, Experience Design Director, Ford Motor Company
13:30-14:00	德州仪器技术助力打造更安全、更智能的车辆 Driving safer and smarter vehicles with TI	卢璟，德州仪器，德州仪器汽车信息娱乐系统总经理 Jane Lu, Infotainment Sector General Manager, Texas Instruments
14:00-14:30	纯电动及低速 48 V 汽车电动化解决方案 Electrification Solutions and Incremental Business for BEV and Low Speed 48 V Vehicles	Mustafa Dinc，威世科技，汽车业务开发资深副总裁 Mustafa Dinc, Sr VP Business Development Automotive, Vishay Intertechnology, Inc.
14:30-15:00	瑞萨赋能高性能E/E架构 Renesas enables high-performance E/E architectures	朱桦，瑞萨电子，高级市场经理 Joe Zhu, Senior Marketing Manager, Renesas Electronics
15:00-15:30	助力智能网联，CAN XL通信技术及应用 Empowering Intelligent Connectivity: CAN XL Technology and Its Applications	张剑龙，博世（中国）投资有限公司，资深产品经理 Tony Zhang, Sr. Product Manager, Bosch (China) Investment Ltd.
15:30-16:00	面向未来的汽车电子电气架构挑战 - 同“芯”解决方案 Meet challenge of next generation Automotive E/E Architecture - Tongxin Solution	杨斌，紫光同芯，汽车事业部VP Ben Yang, VP of Automotive BU, Tongxin Micro
16:00-16:30	智能网联汽车数据安全 Intelligent Vehicle Data Security	孙婷婷，北京银联金卡科技有限公司，信息安全高级工程师 Sun Tingting, Senior Security Engineer, BEIJING UNIONPAY CARD TECHNOLOGY CO.,LTD.
16:30-17:00	安全为锚——合见工软汽车电子开发解决方案 Safety as the Anchor - UniVista Automotive Electronics Development Solutions	齐晓彬，上海合见工业软件集团有限公司，产品市场经理 Xiaobin Qi, Product Marketing Manager, Shanghai UniVista Industrial Software Group Co., Ltd.

\*具体议程以现场为准 The specific agenda is subject to the actual situation

## 2024 现场盛况 2024 grand occasion



## 2024 听众抽样名单 2024 Audience sample list

观众人数：447人

Attendance : 447

单位名称	Company
一汽奔腾汽车股份有限公司	FAW Bestune Auto Co., Ltd.
上海蔚来汽车有限公司	Shanghai NIO Automobile Co., Ltd.
吉利汽车	Geely Automobile Holdings Limited
小鹏汽车	XPENG INC.
博世（中国）投资有限公司	Bosch (China) Investment Ltd.
博世华域转向系统有限公司	Bosch HUAYU Steering Systems Co., Ltd.
博世汽车部件（苏州）有限公司	Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd.
麦格纳汽车电子（上海）有限公司	Magna Automotive Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
采埃孚汽车科技上海有限公司	ZF Automotive Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
上海华伟汽车部件股份有限公司	Shanghai Huawei Automotive Parts Co., Ltd.
浙江零跑科技股份有限公司	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江极氪智能科技有限公司	Zhejiang Zeekr Intelligent Technology Co., Ltd.
联合汽车电子有限公司	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.
诺博汽车系统有限公司	Nobo Automotive Systems Co., Ltd.
上海同驭汽车科技有限公司	Shanghai Tongyu Automotive Technology Co., Ltd.
大陆投资（中国）有限公司	Continental Holding China Co., Ltd.
小米汽车科技有限公司	Xiaomi Auto Co., Ltd.
上海海拉电子有限公司	Hella Shanghai Electronics Co.Ltd.
华为技术有限公司	Huawei Technologies Co., Ltd.
塞拉尼斯（中国）投资有限公司	Celanese (China) Holding Co., Ltd.
松下电器机电（中国）有限公司	Panasonic Industry (China) Co., Ltd.
浙江三花智能控制股份有限公司	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd.
哈曼（中国）投资有限公司	Harman International (China) Holding Co., Ltd.
小米集团	Xiaomi Technology Co., Ltd